

ベンチャー向け株式市場の相次ぐ創設などを背景に、ベンチャー投資への関心が高まっている。投資主体もベンチャーキャピタルからエンジェル（個人投資家）、事業会社、非営利組織（NPO）まで視野が広がってきた。外資の動きも活発だ。今、投資家の資金を束めているのはどのような企業なのか。その技術やサービスはどのような内容で、将来の成長戦略をどう描いているのか。各社の素顔を覗いた。

米国勢が圧倒気味のパソコンに対し、日本勢の巻き返し

半導体パッケージ大容量化

ノース

が期待される携帯電話。日本が先行したインターネット接続機能に続き、映像の撮影・再生、音楽再生、メモリーカード搭載など次世代携帯電話はますます高機能化する。それを支えるのが半導体関連ベンチャー

1、ノース（東京、飯島朝雄社長）のプリン

【主な出資受け入れと資金活用計画】
2000年2月ジャフコ、日本テクノロジーベンチャーパートナーズ投資事業組合などに2億円の第三者割当増資を実施。今年7月にも6億円の増資を計画。このうち3億～4億円を10月に県産に入る福島県の白社工場の新ライン建設に充てる。

「携帯」の機能向上を支える

ト基板小型化技術と半導体パッケージの高機能・大容量化技術だ。

現在、携帯電話で使

要にし、従来は八層だった基

板形成層を四層に縮めた。プ

ノースが携帯電話の小型・多機能化に対応し始めたのは一九九三年。半導体とプリン

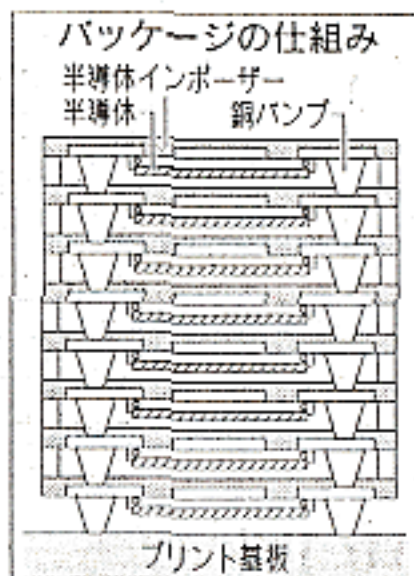
われているプリント基板はレーザー方式で作っている。基板を形成する層を電氣的に接続する突起（バンプ）部分を

作るために、レーザーで穴を

ト基板の間に介在させて半導

リアルにするなどカードの性

（上原博博）
11月曜掲載



「半導体インボウ」の開発に着手した。従来、横たに並べていた半導体と上下に重ねて接続でき、半導体パッケージ処理の高速・高機能化や記憶容量の大容量化に役立つ。そのカギとなるのがバンプの製造技術で、プリント基板の小型化技術は半導体パッケージ技術の副産物だ。

ノースは今年十月から福島県の白社工場で銅バンプ付きの部品を量産、東芝のプリント基板に供給する。東芝のプリント基板は穴開けなどの処

ノースは今年十月から福島県の白社工場で銅バンプ付きの部品を量産、東芝のプリント基板に供給する。東芝のプリント基板は穴開けなどの処

ノースは今年十月から福島県の白社工場で銅バンプ付きの部品を量産、東芝のプリント基板に供給する。東芝のプリント基板は穴開けなどの処